

Lead Frame

影像處理

2021.02

影像處理流程

- 此次測試瑕疵共分三大類：OE有8個、UE有5個、FO有1個，共計14個缺陷樣本。
- 因部分缺陷是發生在背面，故需由背面取像才可檢出，如：OE-1。
- UE缺陷利用反面取像才能突顯瑕疵特徵，OE缺陷則大多是以正面取像呈現較佳效果。
- **正/反同軸落光兩個光學系統是互補的，若架設正/反兩套光學系統此次樣本之瑕疵成像率可達100%。**

蝕刻過度(OE)		
缺陷編號	正面取像	反面取像
OE-1	X	O
OE-2	O	X
OE-3	O	O
OE-4	O	X
OE-5.1	O	O
OE-5.2	O	X
OE-6	O	X
OE-7	O	O
檢出率	87.5%	50%

蝕刻不足(UE)		
缺陷編號	正面取像	反面取像
UE-1	X	O
UE-2	X	O
UE-3	X	O
UE-4	X	O
UE-5	X	O
檢出率	0%	100%

異物(FO)		
缺陷編號	正面取像	反面取像
FO-1	O	X
檢出率	100%	0%

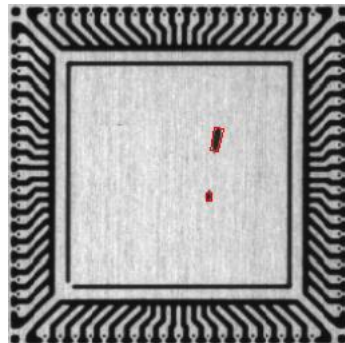
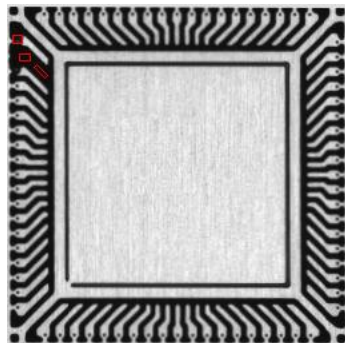
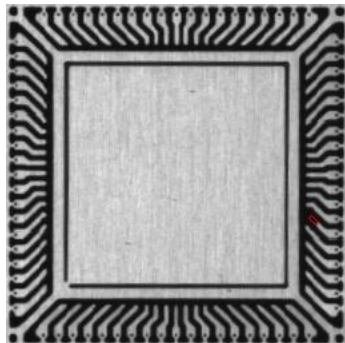
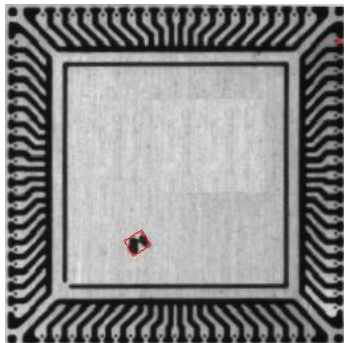
O：可成像且可檢測
X：不可成像，無法檢出

Lead Frame(正面)檢測結果

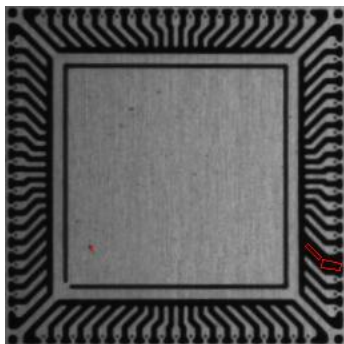
	判NG	判OK	Recall
樣本NG	18(15)	10(4)	65% (79%)
樣本OK	15	265	96%

樣本NG				
	判OK	判NG	Recall	AI Recall
FO 異物	2	1	67%	< 100%
OE 蝕刻過度	2	14	87.5%	= 87.5%
UE 蝕刻不足	<u>6</u>	<u>3</u>	<u>33%</u>	<u>0%</u>

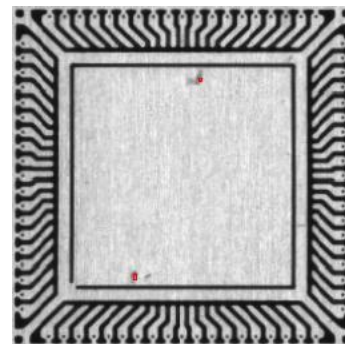
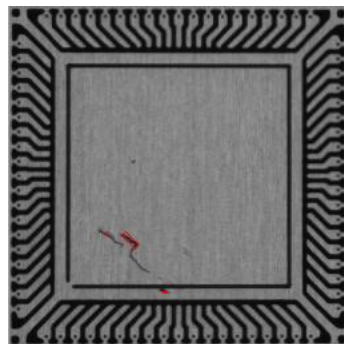
OE



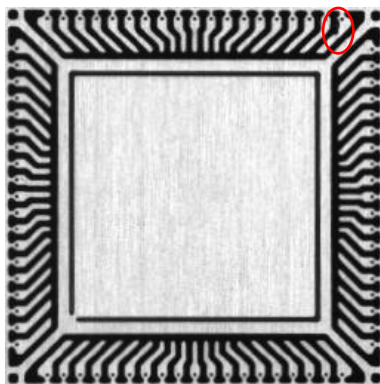
FO



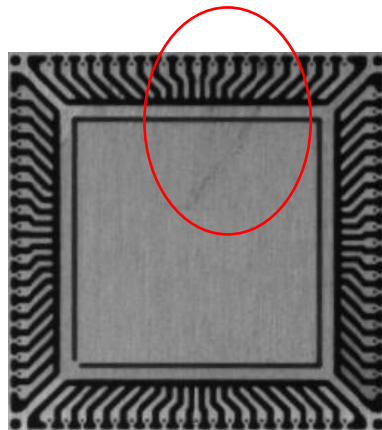
UE



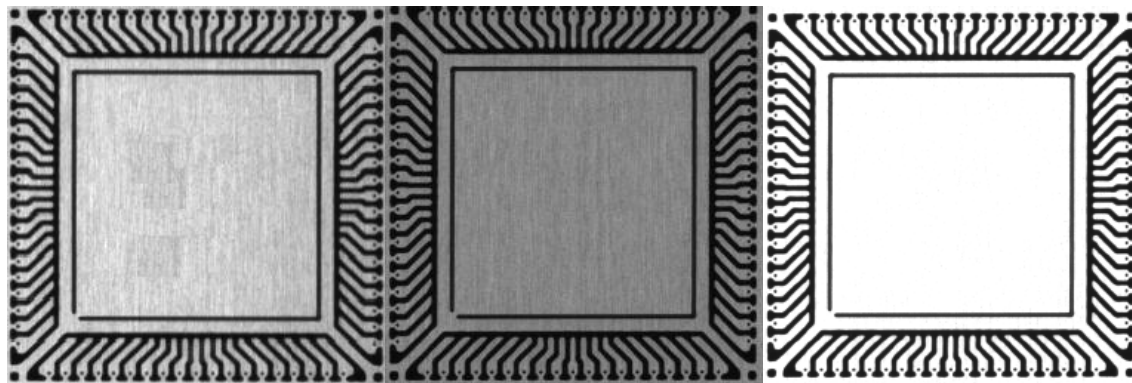
NG被誤判成OK



OE
蝕刻過度



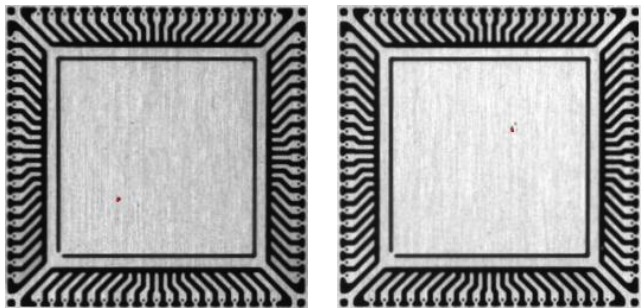
FO
異物



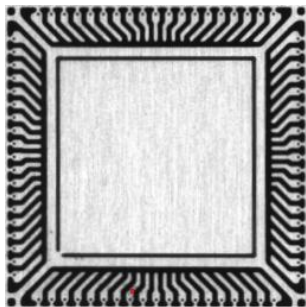
UE
蝕刻不足

OK被誤判成NG

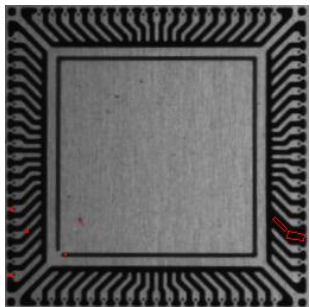
雜點



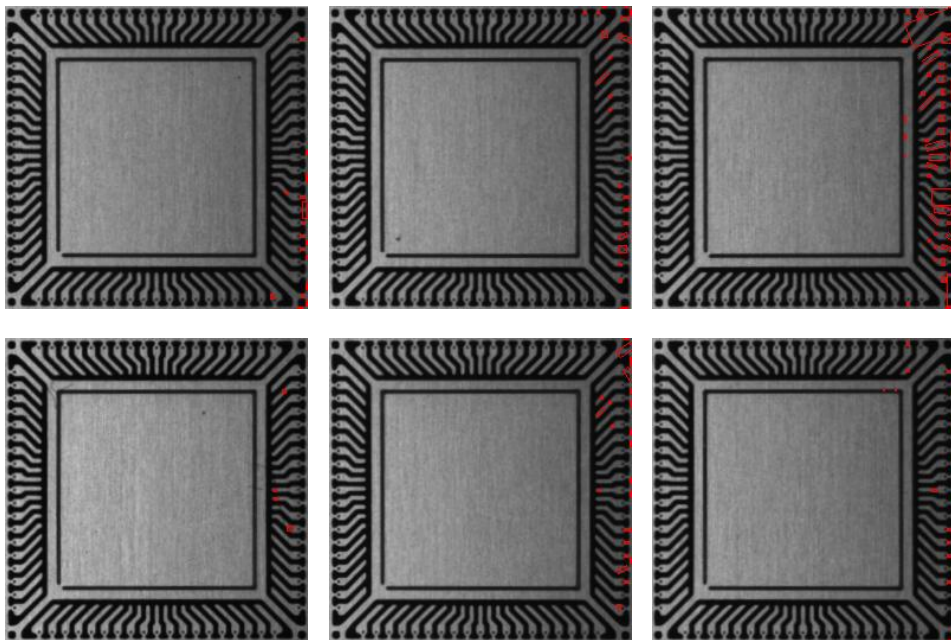
雜點



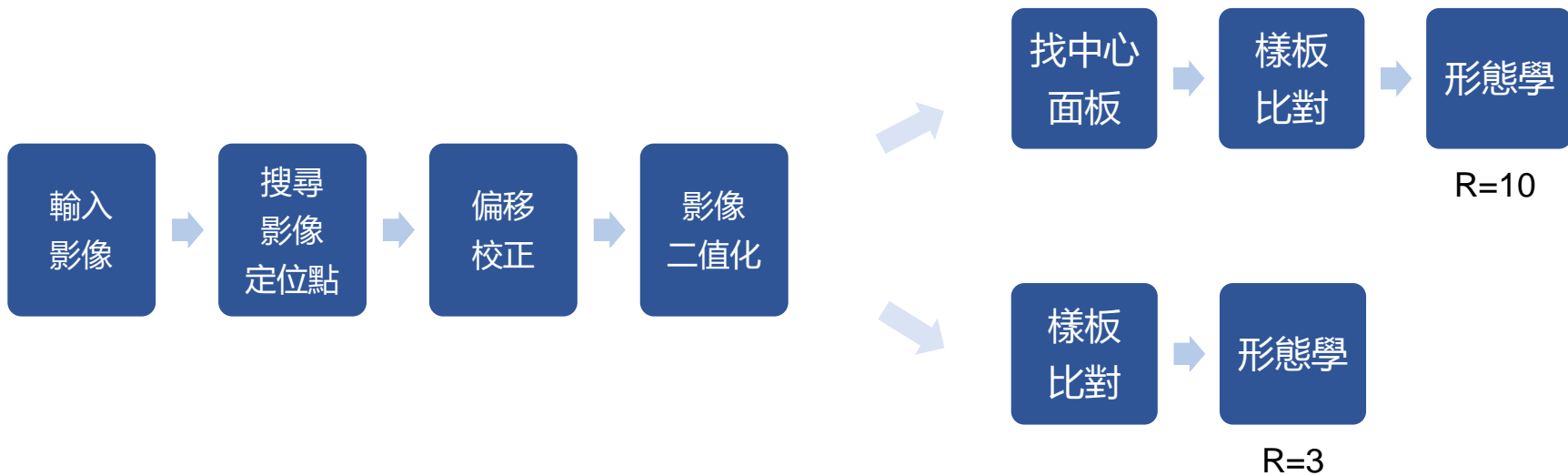
OE?



光線不均

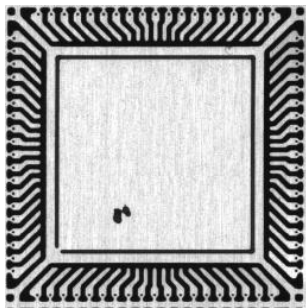


影像檢測流程

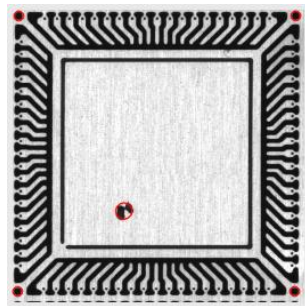


影像檢測流程

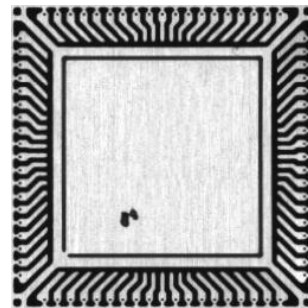
輸入影像



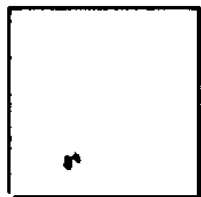
搜尋影像定位點



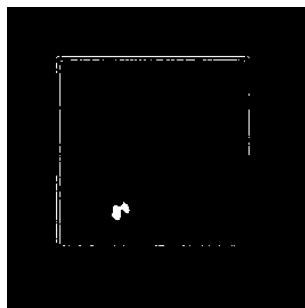
偏移校正



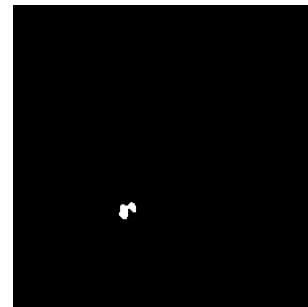
影像二值化



與OK樣板比對

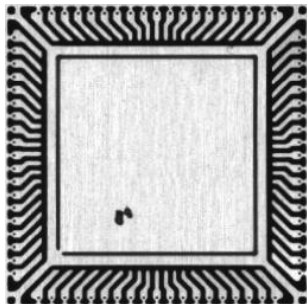


形態學

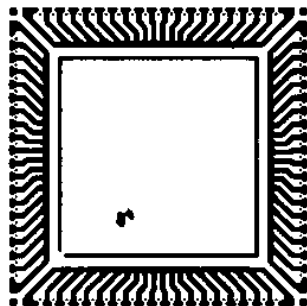


影像檢測流程(中心面板)

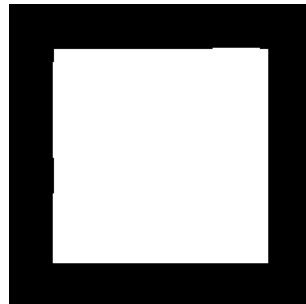
偏移校正



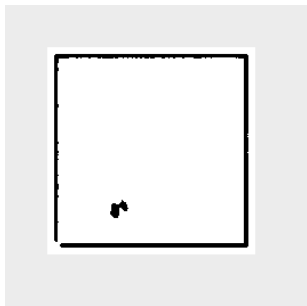
影像二值化



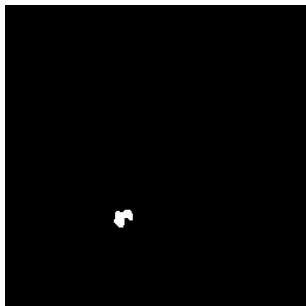
形態學



找中心面板



形態學



影像處理流程

拍攝影像



影像校正

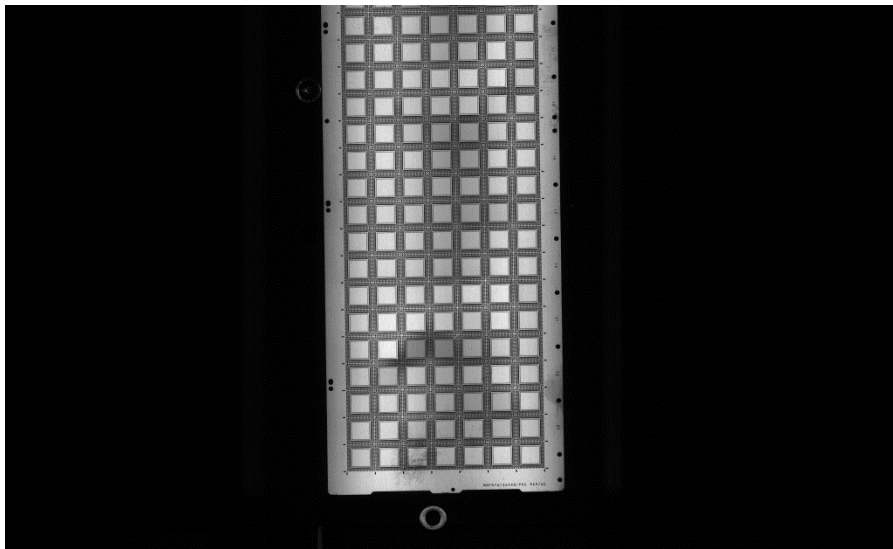


影像切割

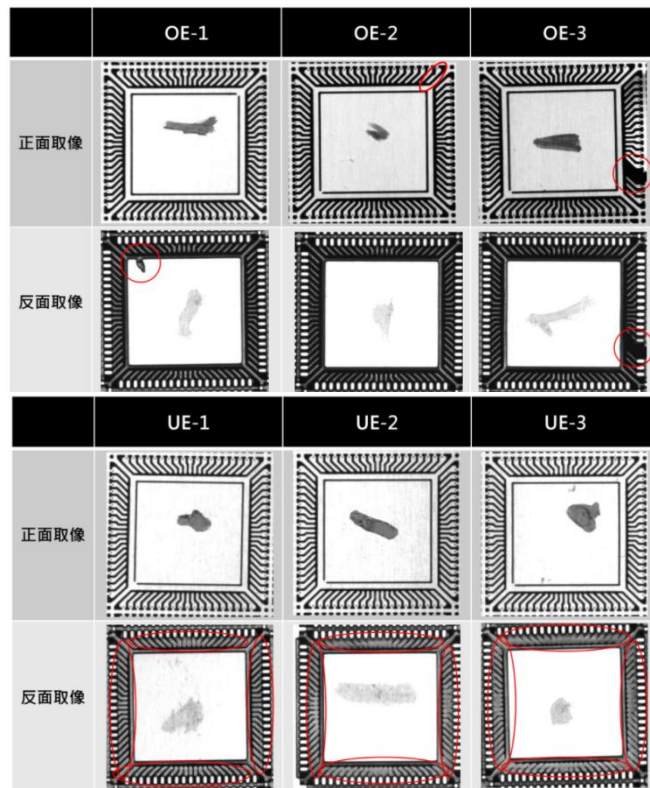


AI分類

拍攝影像

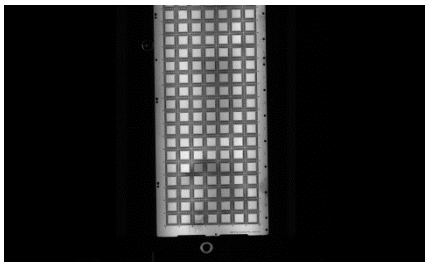


AI分類

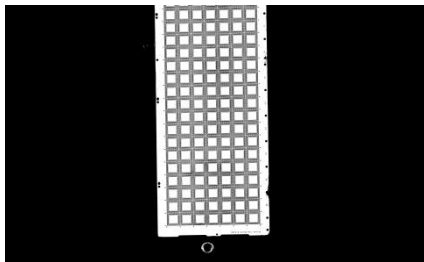


影像校正

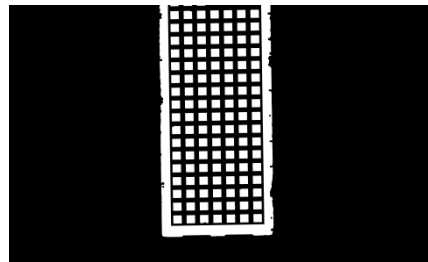
輸入影像



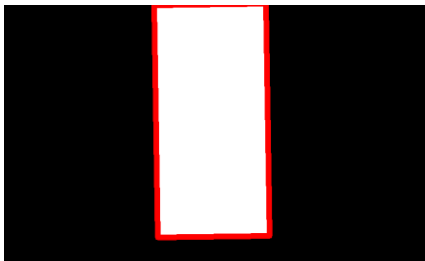
影像二質化



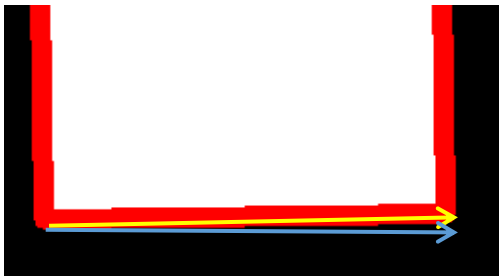
形態學



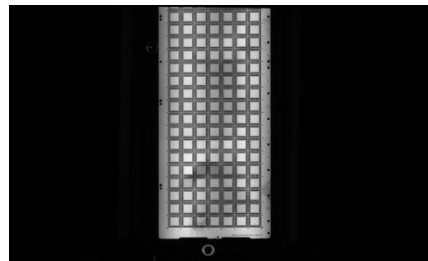
最小矩形



計算偏移角度

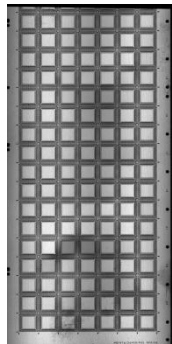


校正影像

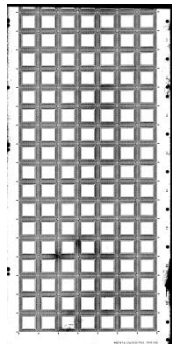


影像切割

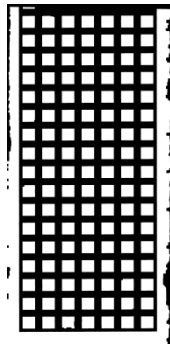
校正後影像



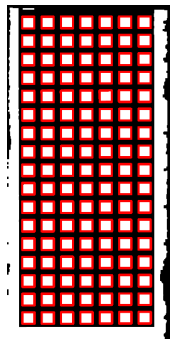
影像二質化



形態學



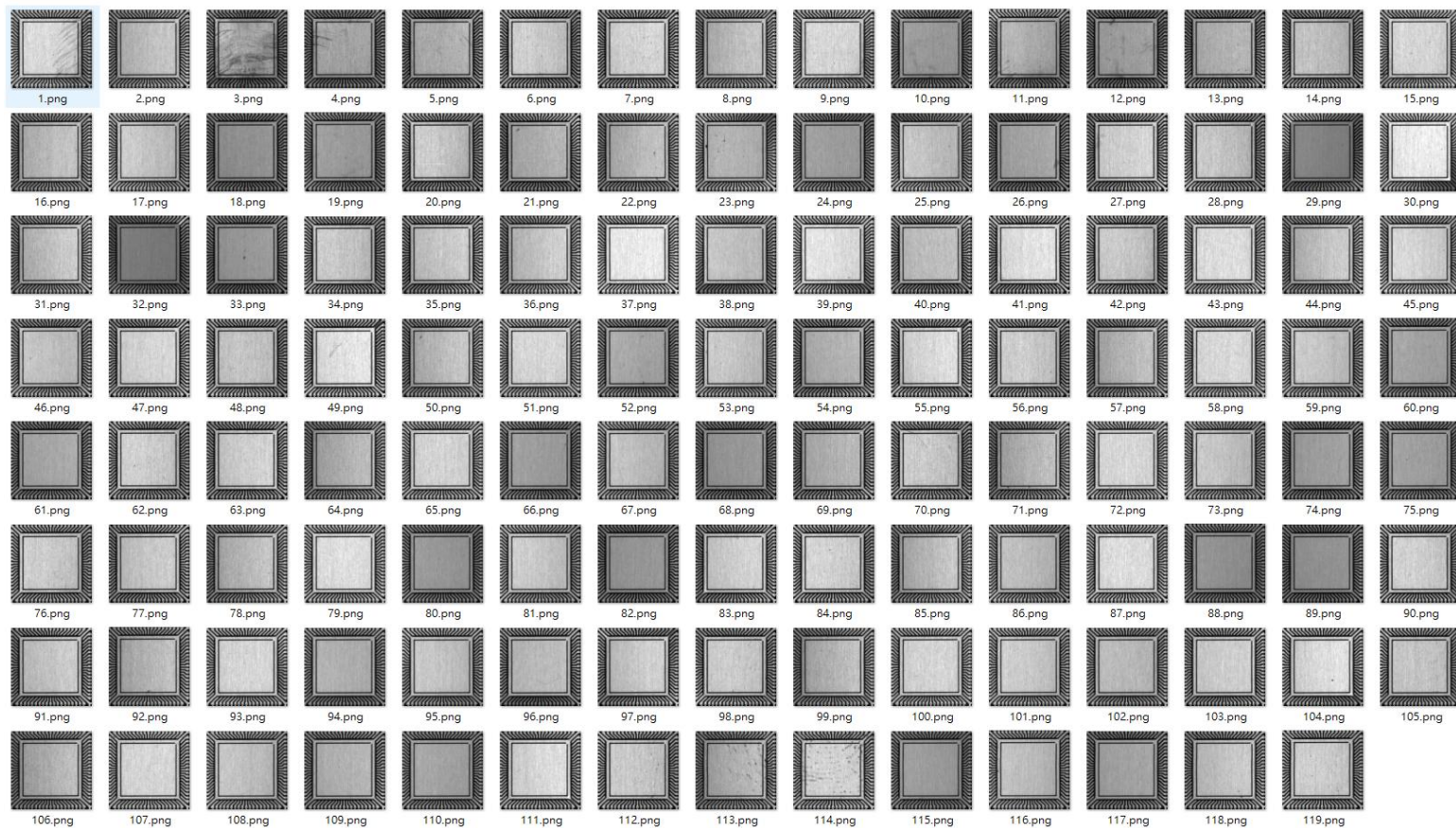
最小矩形



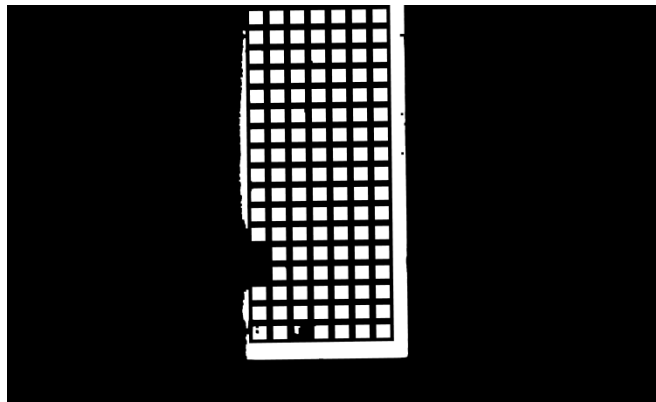
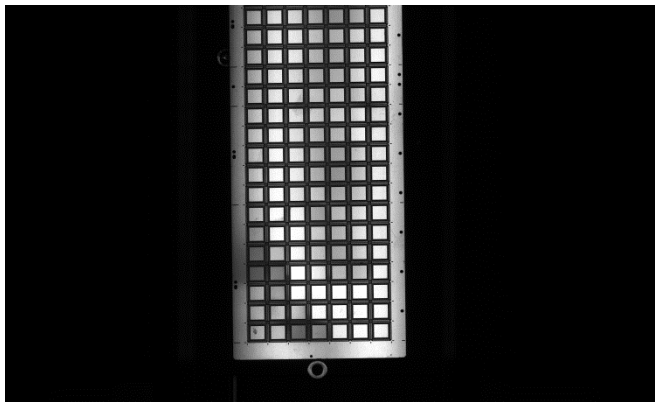
限制 w, h

影像切割




裁切後的影像(Lead Frame正面)



光線不均造成的影響



開發規劃

	W106	W107	W108	W109	W120	W121	W122	W123
面板切割								
正面偵測								
背面偵測								
整合							